

习，养使仿件、及优化半  
 体器件与。合半体器件原与光  
 ，主习优化半体器件仿力。到  
 ：1.了仿具发况，主，  
 半体器件发势与仿义。2.利CAD  
 器件仿、器件仿原与分。3.  
 利代化工具、及优化半体器件，养  
 主习。

教师风采



，信员，KA博，主  
 向光信器件原与，半体光器，发光  
 与，光，可光信与下光信。  
 主兼IEEE P J副主，APLP  
 ，三代半体产业创(CA A)创促员会  
 员。



，信光与副，  
 博。内包周与体光、  
 与型光功与(包二、  
 、光变)与器件、器习在  
 与光，发A M, L: &  
 A 刊100，含4 E I 与  
 15 IF>10 刊。前主：B(上)、半体、半体器件  
 ，：偏光原与。



，博，历任C公司、，上  
 公司。主从事件块发、件、  
 务和器件仿作，具丰化合半体器件仿和；  
 仿件GN半体发光二和光了

， 了 G N 半 体发光二 中 佳 个 、优化 A G N  
 以及 势 其发光 响； 出了可以 G N 半 体发光二  
 发光 舍 变化 I G N 势 和 A G N-G N-A G N 型 ；  
 了 型和 传 型在 G N 半 体发光二 中 作 ， 以 一作  
 及合作 份在 A P L 、 J A P 、 O Q  
 E 和 IEEE J Q E 国 发 。



， 博 ， 历任 C / ， 上 公  
 司 发 。主 使 M M P 了公司  
 件 和 ； 发了几何光 中 光  
 和 光 口； 发了 ；  
 发了 于 光 光 LED 仿 ； 发了 和 NEG F  
 仿 块； 发了 介 中 型； 发  
 了 于压 件 件 取功 ； 发了 半 体光 和  
 器件 仿 例 了 准；发 了 10 。



二 ， 博 ， 上 公司 。主  
 向 与器件仿 原型 发与 。博 在 光  
 发 作，在 N J P 、 O C 、  
 P R A 刊上发 。

### 课程设置

1. 修 ( 及)  
、半 体
2. 内 及  
利 CAD、C AP 和 PIC 3D 先  
仿 件， MO FE /FINFE 与 化 HEM / BD  
器件，与 / LED、 半 体 光器及 APD

光器件仿，养 半 体器件、仿、分 动 力，分、和 仿力。包 18 仿、件 与习，18 仿 和 例分。习，具使 仿 件、及优化半 体器件 与合半 体器件原 与光，主 习优化半 体器 件 仿 力。

	内 及
7 6 周三上午 3-4 ,9:55-11:35	介
7 8 周五下午 6-9 ,13:30-17:05	器件 与仿 发 与 光 器件 与仿 CAD、AP 仿 介、 与。
7 12 周二下午 6-9 , 13:30-17: 05	CAD 仿，、参、 型、出 制与分。
7 15 周五下午 6-9 , 13:30-17: 05	AP 器件仿，件关、 、介、出与分
7 19 周二下午 6-9 , 13:30-17: 05	C PREM 仿 及其与 AP 件光 合仿
7 25 周一下午 7-8 , 14:25-16: 10	仿 1: MO FE
7 27 周三下午 7-8 , 14:25-16: 10	仿 2: FINFE
8 1 周一下午 7-8 ,14:25-16: 10	仿 3: G N HEM
8 3 周三下午 7-8 ,14:25-16: 10	仿 4: G N BD
8 8 周一下午 6-9 ,13:30-17: 05	仿 5: LED 仿 6: 光 LED
8 15 周一下午 6-9 , 13:30-17: 05	仿 7: 半 体 光器 仿 8: 半 体 光器
8 22 周一下午 7-8 , 14:25-16: 10	

3. 及  
，包 出勤（20%）、（20%）和 与  
告（60%）

4. 参

1. C

2. 3D CAD  
-C

CMO N D ,